

证券代码：688035

证券简称：德邦科技

公告编号：2023-037

烟台德邦科技股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会就2023年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可（2022）1527号文《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，烟台德邦科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,556.00万股，每股发行价格46.12元，募集资金总额为164,002.72万元，扣除不含税发行费用152,543,951.12元后，本公司本次募集资金净额为1,487,483,248.88元。

募集资金总额扣除承销及保荐费（含税）人民币135,894,306.56元后的募集资金为人民币1,504,132,893.44元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2022年9月14日汇入公司在招商银行股份有限公司烟台分行开立的账号为535902385410508的人民币账户内，并经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具永证验字（2022）第210029号《验资报告》予以验证。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金人民币633,573,506.45元，其中2022年度累计使用募集资金570,931,824.05元，2023年上半年度使用募集资金合计62,641,682.40元，均投入募集资金投资项目。

项 目	金额（元）	说明
募集资金到账验资金额	1,504,132,893.44	
减：置换以自筹资金预先支付的发行费用	7,283,018.76	
支付发行费用	9,366,625.80	
募集资金净额	1,487,483,248.88	
减：截至报告期末募集资金累计使用金额	633,573,506.45	
加：利息收入和理财收益	13,276,567.91	
使用闲置募集资金购买大额存单或理财产品净额	358,290,000.00	
截止 2023 年 06 月 30 日募集资金专户余额	508,896,310.34	

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《烟台德邦科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户管理。公司募集资金存放于专用银行账户，并与保荐机构、银行签订了募集资金专户存储三（四）方监管协议，明确了各方的权利和义务，以保证专款专用，上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金专用账户的存储情况如下：

开户银行	账号	募集资金余额（元）	备注
招商银行股份有限公司烟台分行	535902385410616	302,281,669.15	
招商银行股份有限公司吴江支行	535902385410266	44,756,625.14	
招商银行股份有限公司烟台分行	535902385410906	532,503.54	
华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行	12656000000901666	59,391.75	
中国光大银行烟台经济技术开发区支行	38080188000258467	7,313,910.19	
招商银行股份有限公司烟台分行	535902385410508	149,155,243.76	
中信银行股份有限公司烟台自贸区支行	8110601011601495861	46,934.28	

开户银行	账号	募集资金余额 (元)	备注
招商银行股份有限公司吴江支行	535902385410968	991,800.58	
兴业银行股份有限公司烟台分行	378010100100862080	696,320.13	
中国光大银行九隆支行	38090188000191019	668,145.54	
招商银行股份有限公司烟台分行	535904836910706	0.00	
招商银行苏州分行运营中心	512910748910966	2,393,766.28	
华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行	12656000000931613	0.00	
合 计	/	508,896,310.34	/

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2023 年 6 月 30 日，募投项目的资金使用情况详见附表 1《2023 年半年度募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于 2022 年 9 月 30 日召开公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 90,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元

机构名称	产品名称	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率	收益
华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行	大额存单	144,790,000.00	2022/10/21	2025/10/21	3.20%	固定收益

兴业银行股份有限公司烟台分行	大额存单	20,000,000.00	2022/10/27	2025/10/27	3.20%	
	大额存单	50,000,000.00	2022/11/3	2025/11/3	3.20%	
招商银行股份有限公司吴江支行	点金系列看跌三层区间92天结构性存款	16,000,000.00	2023/5/30	2023/7/31	1.48%-3.50%	保本 浮动 收益
		26,000,000.00	2023/6/19	2023/9/18	1.48%-3.50%	
		39,000,000.00	2023/6/19	2023/9/18	1.48%-3.50%	
		30,000,000.00	2023/6/29	2023/7/30	1.48%-3.50%	
兴业银行股份有限公司烟台分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	29,000,000.00	2023/6/27	2023/9/27	2.63%	
中国光大银行九隆支行	7天通知存款	3,500,000.00	2023/4/4	2023/8/3	2.00%	固定 收益
合计	/	358,290,000.00	/	/	/	/

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于2023年2月15日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》，同意公司使用人民币30,776.20万元超募资金投资设立全资子公司四川德邦新材料有限公司，由该公司作为实施主体开展“新能源及电子信息封装材料建设项目”。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）“年产35吨半导体电子封装材料建设项目”实施主体、实施地点、拟投入募集资金变更

2023年4月14日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，将“年产35吨半导体

电子封装材料建设项目”实施主体、实施地点、拟投入募集资金做了如下调整变更：

项目名称	变更事项	变更前	变更后
年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目	实施主体	德邦（苏州）半导体材料有限公司	四川德邦新材料有限公司
	实施地点	苏州市吴江区汾湖高新区黎里镇 318 国道北侧	四川彭山经济开发区产业大道 12 号
	拟投入募集资金（万元）	11, 166. 48	6, 241. 99

“年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目”调减募集资金拟投资金额 4, 924. 49 万元，其中 3, 211. 62 万元拟用于新建研发中心建设项目的追加投资，剩余部分 1, 712. 87 万元及相关利息及理财收益继续留存于募集资金专户，并尽快科学、审慎地选择新的投资项目。

（二）“新建研发中心建设项目”实施主体、实施地点、拟投入募集资金变更

2023 年 4 月 14 日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，将“新建研发中心建设项目”实施主体、实施地点、拟投入募集资金做了如下调整变更：

项目名称	变更项	变更前	变更后
新建研发中心建设项目	实施主体	德邦（苏州）半导体材料有限公司	德邦（昆山）材料有限公司
	实施地点	苏州市吴江区汾湖高新区黎里镇 318 国道北侧	昆山市千灯镇朱家山路西
	拟投入募集资金（万元）	14, 479. 23	17, 690. 85

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日

附表 1:

2023 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：烟台德邦科技股份有限公司			金额单位：人民币万元							
募集资金净额			148,748.32			报告期内投入募集资金总额		6,264.17		
						已累计投入募集资金总额		63,357.35		
报告期内变更用途的募集资金总额			1,712.87					-		
累计变更用途的募集资金总额			1,712.87							
累计变更用途的募集资金总额比例			1.15%							
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总 额（1）	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末投资 进度（%）（3） =（2）/（1）	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现的效 益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目										
高端电子专用材料生 产项目 ^[注 1]	否	38,733.48	38,733.48	5,980.14	37,773.32	97.52%	2023 年 12 月	18,105.90 ^[注 2]	不适用	否
年产 35 吨半导体电 子封装材料建设项目	是	11,166.48	6,241.99	-	-	-	2024 年 9 月	不适用	不适用	否
新建研发中心建设项 目	是	14,479.23	17,690.85	-	-	-	2024 年 9 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		64,379.19	62,666.32	5,980.14	37,773.32	60.28%				
超募资金投向										
超募资金永久补流	否		25,300.00		25,300.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
新能源及电子信息封 装材料建设项目	否		30,776.20	284.03	284.03	0.92%	2025 年 2 月	不适用	不适用	否
超募资金	否		30,005.80	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计			86,082.00 ^[注 3]	284.03	25,584.03	29.72%				
合计		64,379.19	148,748.32	6,264.17	63,357.35	42.59%				

未达到计划进度的情况和原因	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用